

【H1BY1】 確率=1/319.7 確変=65.0% 電サポ=フル/100回 賞球=4&1&3&4&14&14
 【9BU1】 確率=1/99.9 確変=100.0%(ST=6)
 電サポ=ST含/20/40/60/80/100回 賞球=4&1&4&10&10

- 潜伏確変仕様…なし
- 保留メモリー…8個
- 保留消化…電チュー優先消化
- ラウンド変動…あり
- 小当たり…あり
- 【9BU1】は無し
- 特賞…右打ち

【MAX出玉】

【H1BY1】	【9BU1】
(下、上共通 14個/10C)	(下、上共通 10個/10C)
・下 4R … 520個	・下 2R … 180個
・下実 5R … 650個	・下(実)4R … 360個
・下 6R … 780個	・下 6R … 540個
・下 8R … 1,040個	・下 8R … 720個
・下(実)10R…1,300個	・下 10R … 900個
・下 10+ 上 5R…1,950個	・下 10+ 上 5R…1,350個

■遊技盤の仕様■

＜アクリルパネル＞

【参考修正ゲージ】

＜参考盤面傾斜= 分 厘＞

サブデジメモリー

メインメモリー

【設置確認項目】 (新台)

- ①番号確認 (遊技盤・枠・主基板)
- ②主基板 (かしめ・封印シール)
- ③払出基板 (ケース破損・開封)
- ④その他基板 (破損・開封・コネクタ)
- ⑤遊技釘・風車 (本数・形状・材質)
- ⑥発射装置 (実発射にて確認)
- ⑦払出装 (実入賞の払出にて確認)
- ⑧図柄作動確認 (液晶・メイン・サブ)

【点検確認】 (部品)

- | | |
|---|---|
| A : 製造番号・番号票の点検
1:遊技盤番・2:枠・3:主基板
B : 主基板等の点検
4:主基板のケース異常・開封
5:主基板の形状異常・異物
6:払出基板のケース異常・開封
7:払出基板の形状異常・異物
8:ロムの形状・装着異常
C : 形状異常・異物の点検
9:周辺基板・10:中継端子板
11:外部端子板・13:コネクタ
12:ユニット接続端子板・14:配線
15:裏パック・16:遊技くぎ及び風車
17:上下皿 | D : 発射装置の点検 (確認)
18:タッチセンサー作動確認
19:発射個数・20:球飛び位置
E : 遊技基本動作の点検 (確認)
21:入賞賞球数・22:最大入賞数
23:役物作動・24:図柄表示作動
F : その他の点検
25:全ての接続箇所点検
26:スピーカーの作動確認
27:各種ランプの点灯確認 |
|---|---|